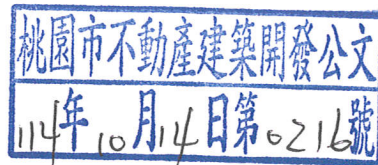


正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：



桃園市政府建築管理處 函

33050

桃園區經國路9號15樓之2

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：專員 林國棟

電話：03-3322101#6115

電子信箱：10048993@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市不動產建築開發商業
同業公會

發文日期：中華民國114年10月3日

發文字號：桃建企字第字第1140093348號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉社團法人台灣智慧建築協會辦理「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」相關資訊，請貴單位轉知所屬及會員參與，請查照。

說明：

- 一、本次展會將邀集國際指標企業及產官學界代表參加，誠摯邀請貴單位參與，拓展國際交流及合作契機。
- 二、詳展會介紹及報名連結、聯絡窗口如附件，請貴單位轉知所屬及會員踴躍報名參加。

正本：桃園市政府智慧城鄉發展委員會、桃園市不動產建築開發商業同業公會、桃園市建築師公會

副本：

處長莊敬權

本案依分層負責規定授權業務主管決行

董事長周鑫世

秘書長吳柏毅

副秘書長柯品涵

秘書陳宇莉

1/4 傳真轉知會員